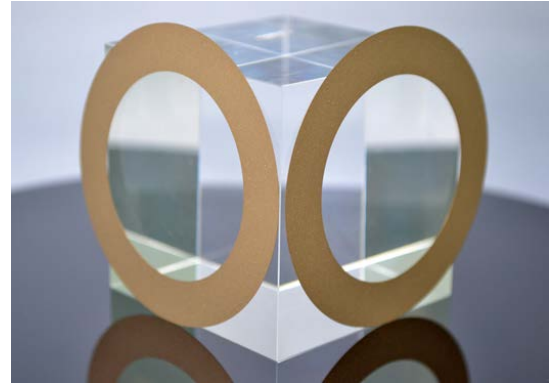


カッティングブレード

砥粒にダイヤモンドを使用した切断・溝入れ加工用のブレードです。豊富なボンドラインナップにより、ガラスやセラミックスなどの脆性材料からCSPやQFNなどの半導体パッケージまで幅広いアプリケーションに対応可能です。また、高度な粒度・集中度コントロールにより、切れ味と寿命のバランスが取れた製品を提供いたします。



加工対象

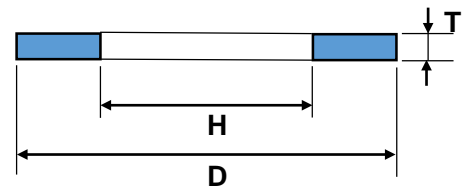
ガラス、水晶、セラミックス、半導体パッケージ
電子部品、光学部品、他

仕様と寸法

SD 800 - 50 - KJ3

56D × 0.2T × 40H

砥粒	粒度	集中度	結合材	加工対象例
SD SDC	#170 ~ #4000	25 ~ 125	KJシリーズ	ガラス
			LCシリーズ	CSP、BGA
			PVシリーズ	磁気ヘッド
			CBシリーズ	セラミックス
			FHシリーズ	セラミックス、QFN



		外径(mm)			粒度(mesh)				
		50 - 56	57 - 78	79 - 100	800 - 4000	600 - 700	400 - 500	270 - 325	170 - 230
刃厚 (μ m)	70	↑			●				
	100				●	●			
	150	↑			●	●	●		
	200				●	●	●	●	
	250	↑			●	●	●	●	
	300				●	●	●	●	●
	400				●	●	●	●	●

※ボンドにより対応可能な組み合わせが異なります。

上記以外にも対応可能な場合があります。詳しくは弊社営業までお問い合わせ下さい。

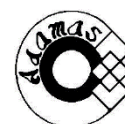
本カタログは予告なく変更することがあります。

株式会社アダマス

〒959-2477 新潟県新発田市下小中山1117-384

電話 0254-33-2211 FAX 0254-33-3756

<http://www.adamas-japan.co.jp/>



Adamas
ADVANCE DIAMOND WHEEL